



GESCHÄFTSBERICHT 1999



LPKF Laser &
Electronics AG

Konzern-Kennzahlen

	1999	1998	1997
Umsatz (in Mio. DM)	38,6	31,9	29,6
EBIT	9,5	8,1	8,0
Cash-flow	7,6	5,4	6,4
Sachinvestitionen	5,6	2,5	2,3
Gewinn je Aktie (in DM)	2,10	1,90	1,89
Umsatz nach Ländern (in Mio. DM)			
Inland	8,5	8,4	7,1
übriges Europa	8,1	8,3	6,7
Nord-Amerika	11,4	7,6	7,3
Asien	10,1	7,3	7,1
Sonstige	0,2	0,3	0,3
Umsatz Produkte (in Mio. DM)			
Laser	17,2	15,6	12,8
Rapid Prototyping	17,1	13,4	14,1
Schablonen	3,4	2,1	1,9
Sonstiges	0,9	0,8	0,8
Mitarbeiter	122	92	85



Inhalt



LPKF Vorstandsmitglied Bernd Hackmann



Konzern-Kennzahlen	2
Grußwort des Vorstandsvorsitzenden	4
Lagebericht LPKF Konzern 1999	6
Organe der Gesellschaft	11
Bericht des Aufsichtsrates	12
Wachstumsmarkt Elektronik – Homemarket für LPKF	14
Konzernabschluss	18



LPKF

Grußwort des Vorstandsvorsitzenden



LPKF Vorstandsvorsitzender Bernd Hildebrandt

Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

das Jahr 1999 war das erste „normale“ Geschäftsjahr der LPKF Laser & Electronics als Aktiengesellschaft. Es zeigte sich für Sie als unsere „shareholder“ und uns als Vorstand, dass wir uns gemeinsam auf einem guten Weg befinden: die eher konservativen Prognosen über Erlöse und Ertrag trafen fast punktgenau ein. Die Kursentwicklung belohnte diese Politik reichlich. Die Aktionäre freut's. Der Vorstand fühlt sich durch den so deutlich werdenden Erwartungsdruck aber noch stärker in die Pflicht genommen.

Nun, bei den vielen Informationsgesprächen, die wir in den vergangenen Monaten mit Investoren und Analysten führten, haben sich zwei Eindrücke herauskristallisiert:

Auf der einen Seite zeigt sich, dass das Interesse an unserem Unternehmen sehr groß ist und noch ständig weiter wächst. Die Experten trauen uns offensichtlich noch einiges zu. Zum anderen nimmt das Verständnis für unsere hochtechnologischen Produkte zu.

Ein Beweis für mich, dass ich mit meinem Anliegen auf dem richtigen Weg bin, Produkte und Strategien unseren Aktionären und denjenigen, die uns zu bewerten haben, noch verständlicher zu machen. Deswegen nutzen wir auch diesen Geschäftsbericht wieder, Ihnen unsere innovativen, richtungweisenden Produkte zu präsentieren und sie zu erklären.

Natürlich profitieren wir vom aktuellen Trend zur Miniaturisierung. Der gegenwärtige Handy-Boom, dessen Ende noch lange nicht abzusehen ist, weil neue Anwendungen wie SMS und WAP dazukommen, beflügelt unser Geschäft. Das wichtigste Erfolgskriterium für ein Unternehmen ist, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt am Markt zu sein. Und das ist uns gelungen.

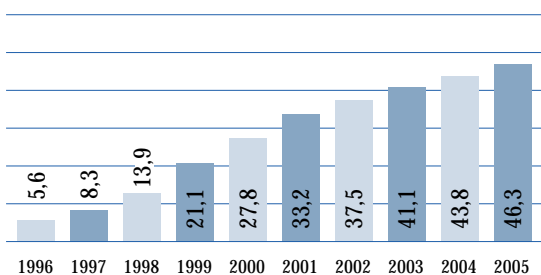
Da die Produktzyklen permanent kürzer werden, müssen Elektronikentwickler, wo auch immer auf der Welt, in die Lage versetzt werden, Produktideen sehr schnell in die Produktrealität umzusetzen. Time-to-Market bzw. Time-to-Profit sind nicht nur Schlagworte, sondern entscheiden über Erfolg oder Misserfolg des neuen Projektes.

Als Marktführer für Rapid Prototyping in der Elektronikindustrie weltweit setzen wir den Standard. In-house Prototyping ist mehr und mehr für die Entwickler ein Muss und genau das ist die Message unseres Marketings. Wochenlange Wartezeiten auf Prototypschaltungen machen wir überflüssig. Der um mehr als die Hälfte erhöhte Auftragseingang in 1999 beweist, dass die Botschaft auch angekommen ist. Hier liegen noch große Absatzpotenziale für uns. Und dass wir als einziger Hersteller Lasertechnologie für Feinstleiterprototypen anbieten, das ist der i-Punkt auf dieser Erfolgsstory.

Zur Montage von Chips auf Leiterplatten werden Druckschablonen benötigt, die ein hochpräzises Auftragen von Lotpaste auf die Leiterplatte ermöglichen. Dies ist jetzt schon machbar, wird aber in den nächsten Jahren ein Zwang für die gesamte Elektronikproduktion sein. Auch hier setzt LPKF mit der lasergeschnittenen Schablone einen Standard. Auf der ganzen Welt weiß der Elektronikmarkt, dass damit die Ausschussquote in der Bestückung drastisch gesenkt wird. Davon profitieren Wachstumsbranchen der Mikroelektronik, wie Telekommunikation, Computer, Medizin- und Steuerungstechnik.

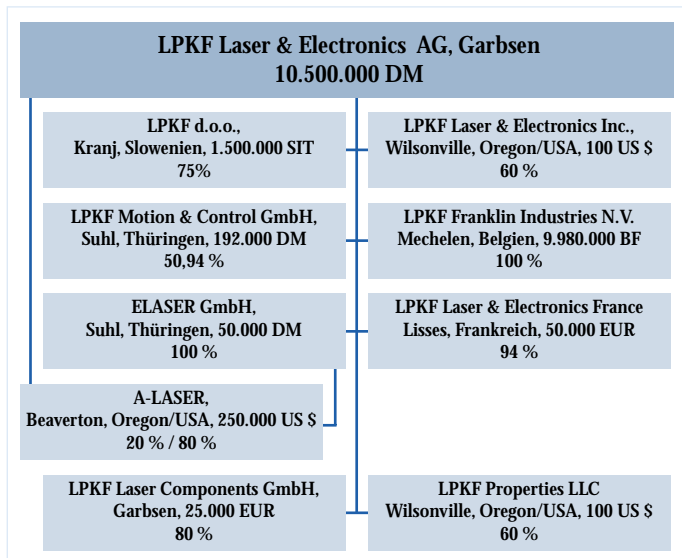
Entwicklung der Mobilfunkteilnehmer in Deutschland in Millionen

(Quelle: Plica Marktforschung Analyse, München)



Höchste Präzision wird natürlich auch bei der Leiterplatte selbst verlangt. Sie muss in der Lage sein, immer winzigere elektronische Komponenten aufzunehmen. Mit hohem technologischen Einsatz wird versucht, Kompromisslösungen zu finden, um in chemischer Ätztechnik Leiterbahnstrukturen zwischen 50 µm und 100 µm bei möglichst geringer Fehlerquote herzustellen.

Die neuen von LPKF entwickelten laserstrukturierten Leiterplattenverfahren, die inzwischen am Markt sind, haben einen neuen technologischen Standard gesetzt.



Natürlich dauert es seine Zeit, auf ein völlig neues Technologiekonzept umzustellen. Viele Gespräche mit Elektronikkonzernen beweisen uns aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das gilt sowohl für den aktuell stark wachsenden Markt der flexiblen Leiterplatte als auch später für die Fertigung von dreidimensionalen Leiterbahnstrukturen, wo wir auch ganz vorne marschieren.

Eines ist aber sicher: LPKF hat sich und wird sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Wir haben es immer wieder verstanden, mit neuen Technologien Standards zu setzen, Marktführer zu werden und zu bleiben. Der Börsengang hat uns in die Lage versetzt, noch schneller die Umsetzung dieser Ziele durch Investitionen in Produktionsanlagen und umfassendes weltweites Marketing zu erreichen. Unsere geschäftliche Basis sind die „traditionellen“ Produktgruppen Rapid Prototyping und StencilLaser mit ihren starken Wachstumsraten. Mit unserem MicrolinerLaser ist uns im Bereich der lasergestützten Mikrostrukturierung von Schaltungen die Einführung einer neuen Technologie gelungen, deren Auswirkungen auf den Elektronikproduktionsmarkt noch gar nicht absehbar ist.

Diese innovativen Fähigkeiten haben uns auch zum gefragten Kooperationspartner gemacht. Erste Verträge über technisch-strategische Partnerschaften sind abgeschlossen: so mit der Mania AG und der Atotech Deutschland, einer Tochter der größten französischen Industriegruppe Elf Aquitaine. Und Weiteres ist angedacht. Es ist spannend, und es bleibt auch weiter so.

Bernd Hildebrandt

Bernd Hildebrandt

Hannover, 23. März 2000



LPKF

LAGEBERICHT LPKF KONZERN 1999

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Das weltweite Marktvolumen bei der Produktion elektronischer Geräte wird im Jahr 2000 erstmals die Grenze von einer Billion Dollar (englisch 1 Trillion Dollar) übersteigen. 1999 lag es noch bei 980 Mrd. US \$. Über 40 Jahre hinweg bedeutet das eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als elf Prozent. Laut VDMA wird bei diesem Wachstumstempo bis zum Jahre 2005 mit einem Produktionswert von ca. 2.000 Mrd. US \$ gerechnet.

Als Indikator für LPKF kann der weltweite Leiterplattenmarkt zugrunde gelegt werden. Dieser wuchs weltweit pro Jahr durchschnittlich um sechs bis acht Prozent. Der deutsche Markt konnte mit dieser Entwicklung nicht mithalten. Sein Wachstum betrug 1998 – neuere Daten liegen nicht vor – nach Angaben des ZVEI nur 2,8 Prozent. Tragende Säulen des Wachstums werden auch weiter Telekommunikation, Datentechnik und Kfz-Elektronik sein.

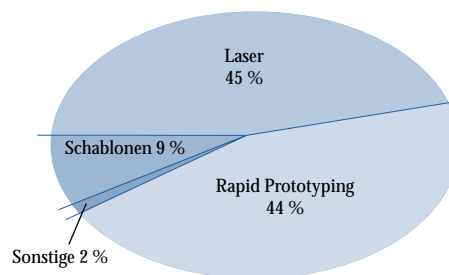
Der Trend verlagert sich verstärkt auf Produktionstechniken für neue Halbleitergenerationen. Der Anteil

der Chips in CSP-Ausführung, der heute bei zwei Prozent liegt, wird bis zum Jahre 2005 bereits bei 20 Prozent liegen. Von dieser Entwicklung profitiert insbesondere die LPKF-MikrolineLasertechnologie.

Die Innovationszyklen in der Elektronik liegen inzwischen bei zwei Jahren, d.h. in dieser Zeit ist ein Produkt bereits veraltet. Diese immer kürzer werdenden Zeiträume bedeuten starke Zuwächse bei der Zahl der Neuentwicklungen und somit gute Marktchancen für LPKF im Rapid Prototyping Bereich.

Umsatzentwicklung

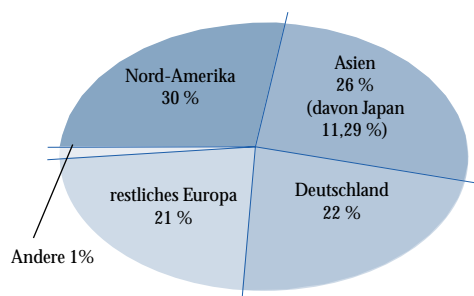
Der Umsatz im Bereich Rapid Prototyping, und dabei besonders bei den Fräsbohrplottern, wuchs im Berichtsjahr kräftig um 26,8 Prozent. Mit dem neuen ProtoMat-Modell C 30, das im April/Mai in den Markt eingeführt wurde, konnte ein weltweiter Standard gesetzt werden.



Im Bereich StencilLaser erhöhten sich die Erlöse um 9,1 Prozent einschließlich der Ersatzteillieferungen und Dienstleistungen. Im Neuanlagengeschäft wurde das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr erzielt. Polymer-StencilLaser wurden 1999 noch nicht verkauft. Allerdings wurden Polymerschablonen als Dienstleistung durch die Tochterfirma Elaser abgesetzt und dadurch die Markteinführung positiv beeinflusst. Mit ersten Verkäufen wird in 2000 gerechnet.

Die geplante Markteinführung des MicrolineLasers verschob sich vom IV. Quartal 1999 in das I. Quartal des neuen Jahres. Ein im Dezember mündlich abgeschlossener Verkaufsvertrag aus dem Medizinbereich wurde inzwischen im Januar 2000 schriftlich bestätigt.

Die Umsätze verteilten sich auf die Länder wie folgt:



Die Umsatzverteilung nach Ländern ist ausgewogen und beinhaltet eine gute Risikoverteilung. Es gibt weder Abhängigkeiten von Ländern noch von Großunternehmen.

Produktion und Beschaffung

Die Produktion von Fräsbohrplottern einschließlich Zubehör sowie Laserquellen erfolgte auch im Berichtsjahr bei LPKF Slovenia d.o.o./Kranj, wobei der Qualitätsstandard deutlich verbessert wurde. Technische Verbesserungen bzw. Neukonstruktionen wurden teilweise direkt vor Ort realisiert. Die Beschaffungspreise blieben weitgehend stabil. Einzelkomponenten werden weitgehend von LPKF d.o.o. direkt beschafft. Endkontrolle bzw. Endmontage finden dagegen unverändert bei LPKF Laser & Electronics AG in Garbsen statt. Im Jahr 2000 soll die Standardisierung nach ISO erfolgen.

Derzeit sind keine Risiken im Produktions- bzw. Beschaffungsbereich erkennbar.



Investitionen

Im Herbst 1999 wurde der Neubau am Stammsitz in Garbsen (Gesamtvolumen ca. 4,5 Mio. DM) mit dem Ziel begonnen, ihn bis September 2000 fertig zu stellen. Darüber hinaus wurde ein MicrolineLaser-System fertiggestellt, das derzeit für Bemusterung und Marketingzwecke eingesetzt wird. Die Investitionen betragen 0,4 Mio. DM.

Im FuE-Bereich im Stammwerk Garbsen bzw. bei dem FuE-Partner Fachhochschule Lage in Lippe/Lemgo wurde in Geräte im Wert von 1,06 Mio. DM investiert.

Für das Geschäftsjahr 2000 sind Investitionen im Bereich FuE-Lasersysteme insbesondere für die Kooperationen Atotech und Mania und für die Endentwicklung des 3D-MID Lasers geplant. Des Weiteren sind Investitionen für den Service von StencilLasern und für die Qualitätskontrolle vorgesehen.

In den USA wurde für LPKF Laser & Electronics Inc. ein neues Firmengebäude errichtet, um die räumlichen Erfordernisse den steigenden Umsätzen anzupassen. Das Firmengebäude ist im Besitz der LPKF Properties LLC, die zu 60 Prozent von LPKF Laser & Electronics AG gehalten wird.

Die deutsche Elaser GmbH hat sich mit 80 Prozent an der A-Laser Inc. beteiligt. Damit ist künftig die Einführung neuer Produktionsprozesse auch in den USA sichergestellt. A-Laser soll sich im Jahr 2000 insbesondere um die Einführung von Polymerschablonen in den USA kümmern, um den Verkauf dieser Systeme durch die LPKF AG zu ermöglichen.



LPKF

Finanzierungsmaßnahmen

Mit dem Mittelzufluss aus dem Börsengang Ende 1998 wurden sämtliche Kosten und Investitionen im Bereich FuE beglichen. Auch die Übernahme von Firmenanteilen bzw. Kapitalanlagen für Neugründungen wurden damit finanziert. Dies betraf A-Laser/Oregon, LPKF



Motion & Control/Thüringen, LPKF Franklin/Belgien sowie als Neugründung LPKF France S.A.R.L./Paris. Darüber hinaus wurden sämtliche mittel- und langfristigen Kredite abgelöst.

Der Neubau in Garbsen wird durch einen langfristigen Kredit fremdfinanziert.

Personalbereich

Im Berichtsjahr 1999 wurde die Zahl der Mitarbeiter von 92 auf 122 aufgestockt. Der Schwerpunkt lag in den Bereichen Produktion, Verkauf sowie Technik und Verwaltung. Die Einstellung von gutem Fachpersonal ist zur Zeit ohne weiteres möglich.

Lage der verbundenen Unternehmen

Elaser GmbH

Die Umsätze in 1999 bewegten sich auf ähnlichem Niveau wie 1998. In 2000 sollte eine Belebung durch Polymerschablonen stattfinden. Um ihrer strategischen Bedeutung gerecht zu werden, hat die Elaser GmbH 80

Prozent der Anteile an der A-Laser Inc. übernommen, die damit zu 100 Prozent dem LPKF Konzern angehört.

A-Laser Inc.

Die Gesellschaft soll mit einem Endkundenservice neue Produkte und Produktionsverfahren in den USA einführen. Für 2000 ist vorrangig die Einführung der Polymerschablone in den USA geplant.

LPKF Motion & Control GmbH

Die Beteiligung wurde auf 51 Prozent erhöht. Im Bereich der Produktion lag die Firma gut im Plan. Die Entwicklung ist durch die Einstellung neuer Mitarbeiter intensiviert worden. Zur Zeit sind neue Steuerungssysteme sowie Antriebe für die Kooperationen mit Ato-tech und Mania in Arbeit.

LPKF d.o.o.

Die Qualität der gelieferten Fräsbohrplotter-Systeme wurde durch aus Slowenien stammende Neukonstruktionen erheblich verbessert. Dabei konnten gleichzeitig die Fertigungskosten der neuen Serie gesenkt werden. Diese Preissenkung wird an die Endkunden unter Beibehaltung der Margen weitergegeben, um so eine stärkere Verbreitung der Produkte weltweit zu ermöglichen.

Die Produktion der Laserquellen für die StencilLaser wurde erfolgreich fortgeführt. Außerdem werden neue Laserkomponenten in Slowenien entwickelt.

Der Standort wurde 1994 bei Gründung der Gesellschaft auch wegen steuerlicher Präferenzen gewählt. Der nachträgliche Widerruf der Steuerbegünstigung führte zu einer Steuernachzahlung. LPKF hält die Nachforderung für ungerechtfertigt und hat dagegen gerichtliche Schritte eingeleitet.

LPKF Laser Components GmbH

Diese Gesellschaft wurde gegründet, um in Zusammenarbeit mit einem Partner in Russland den Know-how-Transfer im Bereich der Lasertechnik zu ermöglichen.

LPKF Laser & Electronics Inc.

Die Gesellschaft agiert als Vertriebs- und Servicepartner des Konzerns in Nordamerika. Die Firma erzielte insbesondere beim Rapid Prototyping starke Umsatzsteigerungen. Seit Sommer 1999 ist dort ein ehemaliger Mitarbeiter der LPKF Laser & Electronics AG als General Manager tätig.

LPKF Properties LLC

Diese neu gegründete Gesellschaft hat den Zweck, Grund und Boden für LPKF Laser & Electronics Inc. zur Verfügung zu stellen. Ihr gehört das 1999 neu gekaufte Firmengebäude, das zur Zeit von LPKF Laser & Electronics Inc. genutzt wird.

LPKF France S.A.R.L.

Diese 1999 gegründete Firma wird sich zunächst vor allem mit dem Vertrieb der Fräsbohrplotter-Systeme in Frankreich beschäftigen. Das Geschäft ist bereits angegangen. Der Geschäftsführer Michel Douezy hat bereits vorher unsere Produkte als Untervertreter in Frankreich mitvertrieben.

LPKF Franklin Industries N.V.

Die Gesellschaft hat mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Es wurden die restlichen Anteile der Gesellschaft gekauft, um eine schnellere Umstrukturierung zu ermöglichen und die Gesellschaft wieder in die Gewinnzone zu bringen. Diese Maßnahmen werden erst im Jahre 2000 wirksam werden.

Forschung und Entwicklung

Im Bereich Forschung und Entwicklung wird mit Hochdruck an Strukturierungsprojekten für die Feinleiterindustrie im Bereich der Mikroline-Systemtechnik gearbeitet. Hier wird im Jahr 2000 mit der endgültigen Markteinführung gerechnet. Am 19. Juli 1999 wurde im Beisein des Niedersächsischen Ministerpräsidenten und der Bundesministerin für Bildung und Forschung gemeinsam mit allen Projektpartnern – 18 Firmen und 4 Hochschulinstitute – das Forschungsprojekt 3D-MID im Hause der LPKF AG erfolgreich abgeschlossen. Parallel dazu entstand eine 3D-Laseranlage (inkl. Steuerung) mit acht Achsen zur Strukturierung von dreidimensionalen Gehäusebauteilen. Wichtigstes Ergebnis dieses Projektes ist die Entwicklung eines laseraktivierbaren Thermoplastmaterials zur additiven, also umweltfreundlichen, selektiven Metallisierung von beispielsweise Polypropylen.

In diesem Zusammenhang wurde eine Pilotproduktionsanlage zur Herstellung von spritzgussfähigem Granulat aufgebaut. Die momentane Produktionskapazität

beträgt rund 40 Tonnen im Jahr. Die Kapazität zur Bemusterung von ersten interessierten Kunden bis hin zur Produktion mittlerer Serien von 3D-MID's ist so abgesichert.

Im Rahmen eines vom BMBF geförderten „MECHATRONIK“-Anschlussprojektes soll voraussichtlich vom 1. Oktober 2000 an eine Übertragung der bereits erarbeiteten FuE-Ergebnisse auf Hochtemperaturthermoplaste möglich sein. Außerdem wird an einer Weiterentwicklung der 3D-MID Laseranlage zur Feinleiterstrukturierung gearbeitet.

Lasersysteme für die Herstellung von Polymerschablonen und zur Bearbeitung von Flexschaltungen werden die Entwicklung abrunden.

Im Berichtsjahr hat sich der Trend zur Miniaturisierung von elektronischen Schaltungen und damit der Einsatz hochpräziser Lasersysteme noch schneller ent-



wickelt als von LPKF in den Vorjahren prognostiziert. Die Entwicklungsaufwendungen der vergangenen vier bis fünf Jahre werden sich in den Folgejahren verstärkt amortisieren.

Auf Grund der gegebenen Erfordernisse des Leiterplattenmarktes kann sowohl im Bereich der erarbeiteten FLEX- sowie der 3D-Lasertechnologien von einer sehr hohen Marktakzeptanz ausgegangen werden. Es ist auch hier u. U. mit zeitlichen Eintrittsverzögerungen zu rechnen, was den Verkaufsbeginn von Mikroline- und 3D-Laseranlagen betreffen könnte.



LPKF



Risikomanagementsystem / Umstellung auf das Jahr 2000 / Umstellung auf den EURO

Zunehmende Globalisierung der Märkte, eine fortschreitende Dynamisierung des Wettbewerbs sowie eine wachsende Komplexität der Technologien prägen das wirtschaftliche Umfeld unseres Unternehmens. Mit dem „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG) sollen die rechtlichen Grundlagen für Risikomanagement- und Kontrollsysteme der Aktiengesellschaften verbessert werden.

Ein effizientes und vorausschauendes Risikomanagement stellt für die LPKF Laser & Electronics AG eine wichtige und wertschaffende Aufgabe dar. Erstes Ziel ist nicht die Vermeidung aller Risiken, sondern deren Identifizierung und Bewertung. Darauf aufbauend wird eine aktive Steuerung im Rahmen einer globalen Risikostrategie entwickelt.

Zur Erfassung und Steuerung von Risiken werden vorhandene Instrumente ständig verbessert und neue aufgebaut.

Die LPKF Laser & Electronics AG hat die Komplexität und die Bedeutung der Jahr-2000-Problematik frühzeitig erkannt und rechtzeitig mit der systematischen Bearbeitung der anstehenden Aufgaben begonnen. So sind weder bei den Produkten noch seitens der Lieferanten Komplikationen aufgetreten.

Die Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Januar 1999 und der EURO als gemeinsame Währung stellen wichtige Schritte bei der Vollendung des gemeinsamen europäischen Marktes dar. Seit dem 2. Quartal 1999 kann im Auftragswesen bereits in EURO abgerechnet werden. Zum 1. Januar 2000 ist die Umstellung der Konzernwährung auf EURO erfolgt.

Darstellung der Lage

Insgesamt war der Geschäftsverlauf 1999 planmäßig und ist als positiv zu bezeichnen. Wichtig für den weiteren Geschäftsverlauf sind die im Dezember 1999 abgeschlossenen Kooperationsverträge mit der Atotech GmbH/Berlin und der Mania AG/Weilrod.

Diese Kooperationen werden zu Neuentwicklungen von Lasersystemen führen, die die Geschäftsentwicklung der kommenden Jahre stark beeinflussen können. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist ausgezeichnet. Sie lässt Raum für anstehende FuE-Projekte und Markteinführungen. Auch der Ausbau des Servicenetzes und sonstige geplante Investitionen können aus eigener Kraft finanziert werden. Kapitalerhöhungen sind derzeit nicht beabsichtigt. Sie könnten aus heutiger Sicht nur durch größere Akquisitionen oder schnelles, ungewöhnlich großes Wachstum im Bereich Laseranlagen notwendig werden.

Die Ertragslage des Unternehmens ist gut und befindet sich im Bereich der Planung.

Es sind keine wesentlichen Risiken in der weiteren Entwicklung der Vermögens-/Finanzlage bzw. der Ertragslage abzusehen.

Ausblick

Die künftige Entwicklung des Unternehmens wird eindeutig geprägt durch eine hochinnovative Entwicklungstätigkeit. Dies betrifft Technologien, die noch weit in der Zukunft liegen, aber auch Systeme und Prozesse, die bereits an der Schwelle zur Markteinführung



stehen. Gleichzeitig mit den genannten technologischen Risiken und Unwägbarkeiten der Marktakzeptanz sind aber auch die großen Chancen zu nennen, die sich LPKF im Wachstumsmarkt Elektronik bieten. Dies kann auch unterjährig zu kurzfristigen und flexiblen Änderungen der Planzahlen führen.

Vorgänge besonderer Bedeutung

Nach Ende des Geschäftsjahres wurde ein Vertrag über ein MicrolineLaser-System abgeschlossen. Das kann als endgültiger Durchbruch bei der Markteinführung dieser neuen Technologie angesehen werden.

Garbsen, im Februar 2000
LPKF Laser & Electronics AG

Bernd Hildebrandt

Bernd Hildebrandt

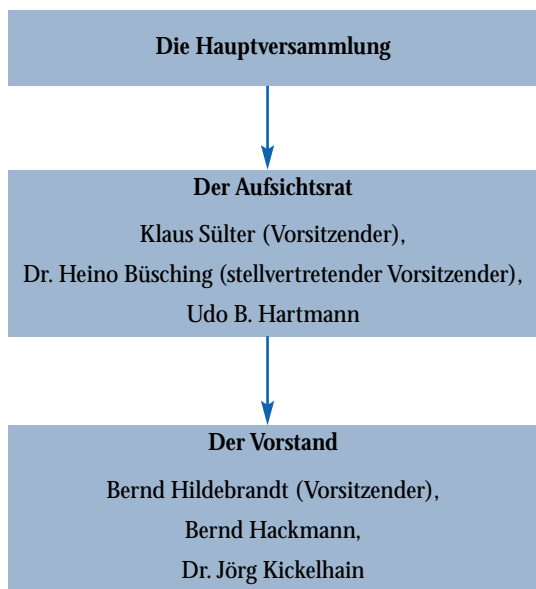
Bernd Hackmann

Bernd Hackmann

Jörg Kickelhain

Dr. Jörg Kickelhain

Organe der Gesellschaft



Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat legt hiermit seinen zweiten Bericht seit der Umwandlung unseres Unternehmens in eine Aktiengesellschaft vor.

Schon in der Zeit vor der Umwandlung haben die Mitglieder des Aufsichtsgremiums eine intensive Zusammenarbeit mit dem Management gepflegt. Diese haben sie nach der Umwandlung fortgeführt und intensiviert. Die Zeit der Umwandlung unserer Gesellschaft und der damit verbundenen Institutionalisierung eines Aufsichtsrats, wie das Gesetz es vorschreibt, fiel zusammen mit einschneidenden gesetzlichen Änderungen und Eingriffen in die bis dahin gegebene Rechtslage. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang beispielhaft das KonTraG, das sowohl dem Aufsichtsrat als auch dem Management ein wesentlich höheres Maß an Verant-



wortung gegenüber den Kapitaleignern, den Mitarbeitern und nicht zuletzt gegenüber der interessierten Öffentlichkeit auferlegt. Dies bedeutete aber keine grundlegende Änderung in der Art und Weise der Ausübung unserer Tätigkeit: die Zusammenarbeit mit dem Management war bereits vertrauensvoll und effizient. Es galt, in diesem Sinne weiterzuarbeiten und das Begonnene fortzusetzen. Der Aufsichtsrat kam im abgelaufenen Geschäftsjahr zu mehr Sitzungen und Bespre-

chungen zusammen, als Gesetz und Satzung dies vorschreiben. Er hat in ständigem Kontakt mit dem Management, wobei die Initiative sowohl vom Aufsichtsrat als auch vom Vorstand ausging, diesen beratend unterstützt und die Ausrichtung des Unternehmens mit diskutiert und geprägt. Der Aufsichtsrat folgte damit konsequent seiner Auffassung, dass er zusammen mit dem Vorstand de facto eine Entscheidungsgemeinschaft bildet. Den vom Vorstand notwendigerweise zu treffenden Entscheidungen gehen informelle Gespräche mit intensivem Meinungs austausch voraus. So kann auch der Aufsichtsrat seinen Überwachungs- und Beratungsaufgaben effizient gerecht werden. Auf diese Weise kann das unternehmerische Know-how, das die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder aus ihren beruflichen Tätigkeiten mitbringen, optimal mit dem Fachwissen des Managements kombiniert und somit wichtige Entscheidungen auf breiterer und gesicherter Grundlage getroffen werden. Die erfreuliche Entwicklung des Unternehmens gerade im zurückliegenden Geschäftsjahr dürfte nicht zuletzt dem praktizierten Zusammenwirken von Aufsichtsrat, Management und Mitarbeitern – unter Wahrung der von Gesetz und Satzung vorgesehenen jeweiligen Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten – zu danken sein.

Eine starke Motivation für den Aufsichtsrat, seine Arbeit im o.g. Sinne fortzusetzen, ist der positive Bekanntheitsgrad des Unternehmens in der Branche, bei Fachverbänden und nicht zuletzt in der interessierten Öffentlichkeit. Dabei wird einer wohl abgestimmten und auf die relevanten Märkte und Marktpartner zugeschnittenen Öffentlichkeitsarbeit große Aufmerksamkeit gewidmet. Es gilt, das Image des Unternehmens, die Corporate Culture, zu pflegen, aber auch geänderten Verhältnissen behutsam anzupassen. Zu diesem Bereich gehört auch eine effiziente Investor-Relations-Arbeit, damit Aktionäre und Analysten jederzeit schnell über Ereignisse informiert sind, die für die Beurteilung der Kursentwicklung relevant sind.

Der Aufsichtsrat hat die ihm von Gesetz und Satzung übertragenen Überwachungs- und Kontrollaufgaben gegenüber dem Vorstand in vollem Umfang erfüllt. Dies gilt insbesondere für die Einrichtung eines Risiko-Management-Systems durch den Vorstand.

Ebenfalls vom Gesetzgeber auferlegt hat das Management – begleitet durch den Aufsichtsrat – der Aufforderung Rechnung getragen, die Lage des Unternehmens nach außen zutreffend darzustellen und über vorhandene Risiken angemessen und unter Berücksichtigung ihrer möglichen Auswirkungen auf das Unternehmen zu berichten. Ein weiterer Schwerpunkt in der Tätigkeit des Aufsichtsrats im Zusammenwirken mit dem Management galt der Verstärkung und Absicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Dabei muss das Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität erreichen, die es ihm ermöglicht, auf die ständig steigenden Anforderungen des Marktes erfolgreich zu reagieren. Der Wert einer kundennahen und kundenorientierten Produktentwicklung ist erkannt und wird ausgebaut und intensiviert werden.

Im vergangenen Geschäftsjahr trat der Aufsichtsrat zu Voll-Sitzungen am 04.02., 26.03., 11.06., 19.08. und am 07.12.1999 zusammen. Hauptgegenstand der Berichterstattung waren in den Sitzungen Februar und März die Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 1998 und deren Beschlussfassung. Weitere wesentliche Schwerpunkte der Sitzungen bildeten insbesondere die Fragen der notwendigen Investitionen, der Verfestigung unserer Position auf den Zukunftsmärkten sowie die Verstärkung von Forschung und Entwicklung. Eine seit langem vom Management verfolgte Strategie zur Sicherung unserer Basis und als Grundlage für ein kontrolliertes Wachstum stellt die Kooperation mit bzw. die Akquisition von geeigneten Unternehmen und, wenn eine Beteiligung oder Übernahme nicht sinnvoll oder möglich erscheint, die Bildung von strategischen Allianzen dar. Mit der so hinzugewonnenen Kapazität sollen der Markt optimal bedient, Synergieeffekte in der Produktion genutzt und die Forschungs- und Entwicklungsarbeit gebündelt werden.

Der Aufsichtsrat fördert diese Bestrebungen uneingeschränkt und wirkt im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben, aber auch als erster Berater des Vorstands, an den zu treffenden Entscheidungen mit. Der Aufsichtsrat kann positiv berichten, dass mit namhaften Firmen, der Firma Atotech GmbH, Berlin, Konzerntochter der Firma Elf Aquitaine, Frankreich, und der Mania AG, ein Unternehmen des „Neuen Marktes“, Kooperationsver-

träge geschlossen wurden. Der Aufsichtsrat ermutigt das Management, diese Politik behutsam weiterzuführen, denn nicht nur der zusammenwachsende europäische Markt setzt entsprechend stabile und ausreichend gefestigte Betriebsgrößen voraus, sondern auch die globalen Veränderungen in allen Bereichen der Wirtschaft zwingen ein Unternehmen, hier eindeutig Position zu beziehen. Wir können berichten, dass wir diese Entwicklungen sorgfältig beobachten und keine Chance ungenutzt lassen, unser Unternehmen zu positionieren.

Der Aufsichtsrat hat die SOCIETÄTS TREUHAND GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 1999 beauftragt. Der Jahresabschluss 1999 ist geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

An der Sitzung des Aufsichtsrats vom 23.03.2000 hat der Abschlussprüfer teilgenommen und über die Prüfung des Jahresabschlusses berichtet und ergänzende Auskünfte erteilt.

Der Aufsichtsrat hat dann seinerseits den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Gewinnverwendung geprüft und den Jahresabschluss gebilligt, der damit festgestellt ist.

Ebenfalls gebilligt wurde der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von DM 4.253.736,88:

- a) einen Teilbetrag von DM 1.050.000,00 zur Ausschüttung einer Dividende von DM 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden,
- b) den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

In die Beratung mit dem Vorstand und den Abschlussprüfern sind auch der Konzernabschluss, der Bericht über die Lage des Konzerns und der Bericht des Konzernabschlussprüfers vorgelegt, in die Prüfung mit einbezogen und zustimmend zur Kenntnis genommen worden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz im Unternehmen und die geleistete Arbeit.

Hannover/Garbsen, den 23.03.2000

Für den Aufsichtsrat:

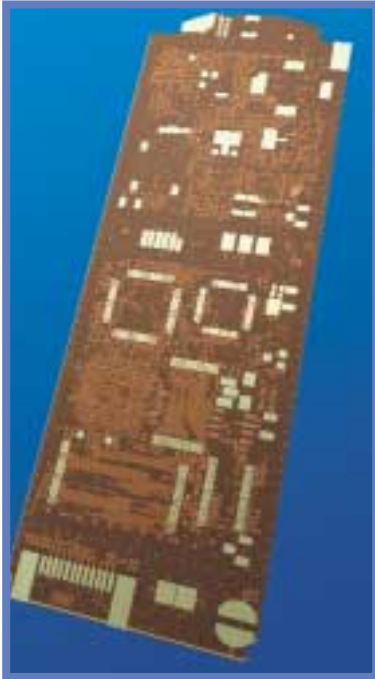
Klaus Sülter, Vorsitzender



LPKF

Was tut LPKF?

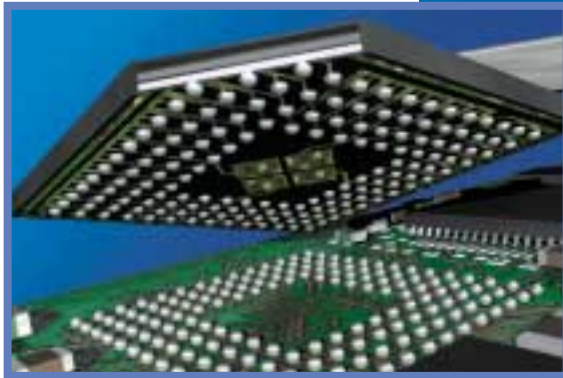
Beispiel: Handyproduktion



Rapid Prototyping

Funktionsfähige Prototypen der bestückten Leiterplatte innerhalb eines Tages herstellen:

LPKF liefert die Technologie und die Geräte.



Chip Size Packaging

Winzige Chips mittels eines flexiblen Schaltungsträgers ankontaktieren:

Der LPKF MicrolineLaser ermöglicht Strukturen, die 5fach feiner sind als heute üblich.

3D-MID

Feinste Leiterbahnen direkt auf dreidimensionale Kunststoffteile aufbringen:

Diese LPKF-Laserstrukturierungs-Technologie ist weltweit einzigartig.



SMD Stencils

Leiterplatten hochpräzise durch feinste Schablonen mit Lötpaste bedruckt:

LPKF lasergeschnittene Schablonen senken den Ausschuss in der Massenproduktion.



Wachstumsmarkt Elektronik – Homemarket für LPKF

Die Elektronikbranche erzielte in den vergangenen Jahren Wachstumsraten wie kein anderer Wirtschaftszweig. Heute bilden die elektronischen Geräte mit einem jährlichen Umsatzvolumen von 980 Mrd. US \$ den weltweit größten zusammenhängenden Markt. Rasant gestiegen ist dabei nicht nur das Volumen, sondern auch das Tempo der Entwicklung. Produkte, die wir heute benutzen, sind in knapp zwei Jahren überholt. Die immer kürzeren Produktzyklen erhöhen den Zeitdruck auf die Elektronikentwickler: Projekte, die noch vor Jahren in sechs bis acht Monaten zur Produktreife geführt werden konnten, müssen heute in wenigen Wochen realisiert sein. „Time-to-Market“ bzw. „Time-to-Profit“ haben inzwischen als Zielvorgaben für die Elektroniklabors oberste Priorität. Angesichts solch enger Zeitrahmen erscheint eine externe Auftragsvergabe für die Herstellung von Prototypenleiterplatten oder beim Bestückungsservice nicht mehr akzeptabel. Der Trend geht also zwangsläufig zum In-house Prototyping, mit der Vorgabe, dass alle Arbeitsschritte von der Entwicklung am Bildschirm bis zur fertig bestückten Leiterplatte vor Ort realisierbar sein müssen.



Vollständige Problemlösung für das In-house Prototyping

Als weltweit einziges Unternehmen liefert LPKF die vollständige Problemlösung für das In-house Prototyping. So lässt sich heute mit LPKF-Technologie der funktionsfähige Prototyp beispielsweise eines Handys im eigenen Elektroniklabor entwickeln und fertigen. Von der Konvertierung der CAD-Daten, über das Isolationsfräsen der Leiterplatten, Durchkontaktieren, Fine-pitch-Drucken, Pick-and-Place-Bestückung und Reflow-Löten liefert LPKF als Marktführer beim Rapid Prototyping nicht nur die erforderlichen Geräte, sondern auch das komplette Prozess-Know-how zur Herstellung einer fertig bestückten Fine-pitch SMD-Leiterplatte innerhalb eines Tages. Dadurch fällt eine externe Auftragsvergabe weg. Lange Wartezeiten und zusätzlicher Kostenaufwand sind überflüssig. Entwicklungszeiten reduzieren sich drastisch.

Miniaturisierung – der Trend geht zur Lasertechnologie

Neben dem gestiegenen Markttempo sehen sich Elektronikentwickler mit den Anforderungen einer immer weiter gehenden Miniaturisierung der Leiterbahnführung konfrontiert. Auch hier liefert die rasante Entwicklung im Bereich der Handys mit der inzwischen selbstverständlichen SMS- und WAP-Technologie das Stichwort: Elektronik, die der Mensch bei sich führt – auch Pager und Laptops gehören hierher – muss leicht, klein und leistungsfähig sein. Gleichzeitig sind immer vielfältigere Funktionen in einem Gerät zu integrieren. Elektronikentwickler stehen deshalb vor der Aufgabe, zunehmend komplexere Schaltungen auf immer weniger Fläche realisieren zu müssen. LPKF ist diesem Trend gefolgt und ermöglicht die Feinstrukturierung der Leiterbahnführung mit dem Laser auch im Laborbereich für das Prototyping von Feinstleiterschaltungen: Das System LPKF ProtoLaser ist derzeit in der Lage, 50µm-Leiterbahnstrukturen zu erzielen.



LPKF



Multilayer jetzt auch beim Prototyping

Unumgänglich ist dabei in vielen Fällen die Ergänzung von ein- oder zweiseitigen Leiterplatten durch Mehrlagenschaltungen. Aufgrund geringer Kapazitätsauslastung und entsprechend hoher Kosten war der Einsatz der Multilayer-Technologie – des mehrlagigen Schichtens und Durchkontaktierens von Leiterplatten, wie es in der Massenfertigung längst üblich ist – beim Prototyping in der Vergangenheit kaum wirtschaftlich. So entstanden ebenfalls Abhängigkeiten von Zulieferern. Auch in diesem Bereich liefert LPKF die Technologie und das komplette Prozess-Know-how. Zügige und kostengünstige Fertigung von Mehrlagenschaltungen im Elektroniklabor ist damit nun ebenfalls eine Selbstverständlichkeit.

Ein Durchbruch: Lasereinsatz bei SMD-Stencils

Fertigungsgeräte für Leiterplatten, insbesondere für die SMD-Fertigung, haben heute ein Marktvolumen von schätzungsweise rund fünf Mrd. US \$. Bis 2003 erwartet die Branche eine Steigerung auf rund elf Mrd. US \$. Neben dem Prototyping hat LPKF mit der StencilLaser-Technologie auch im Bereich der Massenfertigung Anteil an diesem Wachstumsmarkt. Derzeit werden etwa 70 % aller elektronischen Baugruppen weltweit in SMD-Technik hergestellt. Eine Schlüsselrolle in der Massenbestückung der Leiterplatten spielt dabei das Verlöten der SMD-Bauteile. Um das Bedrucken der

Leiterplattenserie mit Lotpaste zuverlässig, zügig und platzsparend zu gewährleisten, haben sich präzise Metallschablonen, sogenannte Stencils, etabliert.

Bereits Anfang der neunziger Jahre hat LPKF bei der Massenfertigung von Stencils neue Maßstäbe gesetzt. Durch erstmaligen Einsatz von Lasertechnik in diesem Bereich ist es gelungen, die Qualität der bis dahin ausschließlich in Ätztechnik hergestellten Lotpastenschablonen entscheidend zu verbessern. Ein Problem dieser Produktionsweise waren die vergleichsweise hohen Ausschussraten als Folge der unpräzisen „chemischen Schnitte“ der Ätztechnik – ein kritischer Produktionsfaktor mit unmittelbarer Auswirkung auf den Gewinn. Mit dem StencilLaser hatte LPKF eine Technologie entwickelt, die es ermöglichte, einmal exaktere Stencils zu schneiden und zum anderen auf Chemie zu verzichten. Gleichzeitig sanken damit die Ausschussraten deutlich. So wurde eine umweltfreundliche und zuverlässige Alternative für die Massenfertigung von Lotpastenschablonen erfolgreich etabliert.

Höchste Präzision durch neue Materialien

Durch die konsequente Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der Lasertechnologie gelang LPKF im vergangenen Jahr mit der Herstellung von Polymerschablonen erneut ein Durchbruch im Bereich der SMD-Stencil-Fertigung. Mit dem LPKF StencilLaser Polymer ist es jetzt erstmals möglich, Lotpas-

tenschablonen nicht mehr nur aus Metall, sondern auch aus hauchdünnem Kunststoff herzustellen. Dieses Material ermöglicht eine nochmals verbesserte Laserschneidqualität und damit ein besseres Druckauslöseverhalten. Höchste Kantenschärfe und Positionspräzision verringern die Druckausschussquote abermals um den Faktor Zehn. Die Anzahl der Druckzyklen wurde erhöht. Gleichzeitig lassen sich bedeutend feinere Strukturen erzielen.

Chip-Size-Packaging – Raum für die Technik von morgen

Ein weiteres erfolgreiches Einsatzgebiet für die LPKF-Lasertechnologie ist der Bereich Aufbau- und Verbindungstechnik (Packaging). Für die nächsten Jahre kündigt sich angesichts der fortschreitenden Miniaturisierung und der Bündelung von immer mehr Leistungsmerkmalen auf einem Gerät ein umfassender Technologiewechsel bei der Anbindung von Chips an. Die Fachwelt ist sich einig, dass die sogenannte CSP-Technik (Chip-Size-Packaging) der einzige Weg sein wird, um die Leiterplatte von morgen zu verwirklichen. Die bisher übliche vergleichsweise aufwendige Chipkontaktierung wird dabei abgelöst durch eine platzsparende Umleitung der Kontakte auf einen sogenannten Interposer, eine feinstrukturierte Miniaturplatine, von der Kontakte zentral abgeleitet werden können. Dieses Verfahren gewährleistet nicht nur eine drastischere Verringerung der Chipgeometrie, einschließlich Verringerung des Gewichts, sondern ermöglicht zusätzlich eine Vervielfachung der Anschlusspunkte. Während der Anteil der Chips in CSP heute noch bei zwei Prozent liegt, sehen die Prognosen ihn im Jahr 2005 bereits bei 20 Prozent.

Die erforderlichen Mikrostrukturen bei der Herstellung der Interposer als auch bei den zugeführten Leiterbahnen werden zukünftig aller Voraussicht nach nur noch unter Einsatz der Lasertechnik erreichbar sein. Mit der MicrolineLaser-Technologie hat LPKF an der Schwelle dieses Wachstumsmarkts dafür die technischen Voraussetzungen geschaffen. Der MicrolineLaser erzielt erstmals Fineline-Strukturen im 20µm-Bereich und übertrifft damit die bisherigen Standards um den Faktor Fünf.

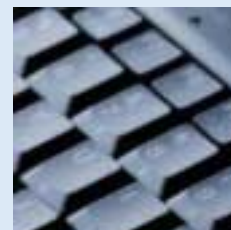
Flexible Schaltungen

Mit Erfolg wird die MicrolineLaser-Technologie auch bei der Fertigung feinstrukturierter Flexschaltungen eingesetzt, die besonders in der Telekommunikation, bei Camcordern, Uhren, medizinischen Geräten und Notebooks verwendet werden. Biigsame und knickfähige Leiterfolien, die sich flexibel der Geräteform anpassen, ersetzen dabei die starren Platinen und schaffen somit ein weiteres Miniaturisierungspotenzial.

Der Sprung in die dritte Dimension

Durch die Entwicklung der 3D-MID-Technik hat LPKF das Tor zu einer neuen Dimension aufgestoßen. Ziel der 3D-Technologie ist es, die mechanischen Komponenten eines Gerätes mit den elektronischen zu verknüpfen. In Zusammenarbeit mit Hochschulwissenschaftlern und weiteren Industriepartnern ist es gelungen, erstmals feinste Schaltungsträger auf Spritzgussbasis zu erzeugen. Das Gehäuse wird dabei selbst zum Leiterbahnträger. Diese Innovation wird bei verschiedenen Anwendungen zum Wegfall der Leiterplatte führen und auf einem breiten Anwendungsgebiet neue funktionale und gestalterische Möglichkeiten eröffnen, von der Telekommunikation über die Medizintechnik bis hin zu Computer- und Fahrzeugbau. Aktuelles Beispiel für eine erfolgreiche Anwendung ist die Arbeit an der Integration der Antenne in das Innengehäuse eines Handys.

Durch eine vorausschauende Firmenpolitik und eine Forschungs- und Entwicklungsaktivität, die bereits in der Vergangenheit die technischen Voraussetzungen für die Technologietrends von morgen geschaffen hat, ist LPKF bestens gerüstet, um bei den sich schon jetzt abzeichnenden Umwälzungen eine Vorreiterrolle einzunehmen. Zu den Zielvorgaben bei der Entwicklung neuer Technologien gehören dabei neben den technischen und wirtschaftlichen Aspekten einer immer weitergehenden Miniaturisierung und Beschleunigung des Marktes immer wieder auch ökologische Gesichtspunkte.



LPKF

Inhalt

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	19
Eigenkapitalveränderungsrechnung	
Konzernbilanz	
Aktiva	20
Passiva	21
Konzernkapitalflussrechnung gemäß IAS 7	22
Konzernanhang	
Grundsätze der Aufstellung des Konzernabschlusses	22
Konsolidierungskreis	22
Konsolidierungsgrundsätze	23
Finanzierungsinstrumente	23
Währungsumrechnung	23
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	
1. Umsatzerlöse	24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25
3. Sonstige betriebliche Erträge	25
4. Materialaufwand	25
5. Personalaufwand und Mitarbeiter	26
6. Abschreibungen	26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27
8. Finanzergebnis	27
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27
Konzernbilanz	
Aktiva	
10. Anlagevermögen	28
11. Vorräte	30
12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30
13. Sonstige Vermögensgegenstände	30
14. Liquide Mittel	30
15. Rechnungsabgrenzungsposten	30
16. Steuerabgrenzungsbetrag	30
Passiva	
17. Gezeichnetes Kapital	31
18. Kapitalrücklage	31
19. Genehmigtes Kapital/bedingtes Kapital	31
20. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	31
21. Rückstellungen für Pensionen	32
22. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen	32
23. Verbindlichkeiten	32
24. Anleihe	33
25. Steuerabgrenzungsbetrag	33
Sonstige Angaben	
26. Kapitalflussrechnung	33
27. Unternehmenserwerbe	33
28. Gewinn pro Aktie	34
29. Dividende je Aktie	34
30. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen	34
31. Sonstige Angaben	34
32. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	35
Bestätigungsvermerk	35
Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics AG	36
Bilanz der LPKF Laser & Electronics AG	
Aktiva	36
Passiva	37
Gewinn- und Verlustrechnung	38

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang		31.12.1999 TDM	1998 TDM
Umsatzerlöse	(1)		38.619	31.932
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			851	115
andere aktivierte Eigenleistungen	(2)		2.950	576
sonstige betriebliche Erträge	(3)		2.017	2.079
			44.437	34.702
Materialaufwand	(4)	9.314		10.085
Personalaufwand	(5)	11.385		7.884
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(6)	3.016		2.077
sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	11.390	35.113	8.988
			9.324	5.668
Finanzergebnis	(8)		-275	-200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			9.049	5.468
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)		4.429	2.450
Konzernjahresüberschuss			4.620	3.018
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter			212	146
Konzernergebnis			4.408	2.872
Ergebnis pro Aktie (in DM)	(28)		2,10	1,37
Ergebnis pro Aktie – verwässert (in DM)	(28)		2,00	1,31

Aufstellung über die Veränderungen des Eigenkapitals für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 1999 (Vorjahr in Klammern)

	Stand 1.1.1999	Kapital- erhöhung aus Ge- sellschafts- mitteln	Einzah- lungen durch Kapital- erhöhung	Ausschüt- tungen an Anteils- eigner	Konzern- ergebnis	Differenzen aus der Währungs- umrechnung	Stand 31.12.1999
	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM
Gezeichnetes Kapital	10.500	-	-	-	-	-	10.500
	(650)	(4.350)	(5.500)	-	-	-	(10.500)
Kapitalrücklagen	17.100	-	21	-	-	-	17.121
	(2.740)	(-2.740)	(17.100)	-	-	-	(17.100)
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Gesetzliche Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Rücklagen für eigene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
Satzungsmäßige Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Andere Gewinnrücklagen	(212)	(-212)	-	-	-	-	(0)
Bilanzgewinn	4.252	-	-	-	4.408	-	8.660
	(5.678)	(-1.398)	-	(-2.900)	(2.872)	-	(4.252)
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung	-159	-	-	-	-	493	334
	(119)	-	-	-	-	(-278)	(-159)
Summe	31.693	-	21	-	4.408	493	36.615
	(9.399)	(0)	(22.600)	(-2.900)	(2.872)	(-278)	(31.693)



LPKF

Konzernbilanz

Aktivseite

	Anhang	TDM	31.12.1999 TDM	31.12.1998 TDM
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	(10)			
Software		91		84
Geschäfts- oder Firmenwert		1.397		35
Entwicklungsleistungen		3.146		551
Nutzungsrechte		1.115		1.007
		<u>5.749</u>		
Sachanlagen	(10)			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		5.431		3.103
technische Anlagen und Maschinen		2.605		2.959
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.191		1.108
geleistete Anzahlungen				
und Anlagen im Bau		1.804		808
		<u>13.031</u>		
Finanzanlagen	(10)			
Anteile an verbundenen Unternehmen		36		36
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen				1.026
Anzahlungen auf Beteiligungen				409
sonstige Ausleihungen		7		2
		<u>43</u>	18.823	
Umlaufvermögen				
Vorräte	(11)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.151		438
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		820		598
fertige Erzeugnisse und Waren		9.831		6.596
geleistete Anzahlungen		269		833
		<u>13.071</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(12)	6.076		4.548
Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				514
sonstige Vermögensgegenstände	(13)	1.665		1.524
		<u>7.741</u>		
Wertpapiere		117		
Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	(14)	12.875	33.804	17.158
Rechnungsabgrenzungsposten	(15)		67	144
Steuerabgrenzung	(16)		375	85
Summe Aktiva			53.069	43.566

Konzernbilanz

Passivseite

	Anhang	TDM	31.12.1999 TDM	31.12.1998 TDM
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	(17)	10.500		10.500
Kapitalrücklage	(18)	17.121		17.100
Gewinnrücklagen, andere Gewinnrücklagen				
Bilanzgewinn	(19)			
Gewinnvortrag		4.252		4.252
Konzernergebnis		4.408		
			36.281	
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung			334	-159
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	(20)		2.163	902
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen	(21)	439		324
Steuerrückstellungen	(22)	1.589		79
sonstige Rückstellungen	(22)	1.330	3.358	1.153
Verbindlichkeiten				
Anleihe	(24)	462		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(23)	3.310		6.448
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				446
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.094		1.536
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				185
sonstige Verbindlichkeiten		3.787	9.653	544
Rechnungsabgrenzungsposten			62	91
Abgrenzungsposten Zuwendungen	(3)		274	
Steuerabgrenzung	(25)		944	165
Summe Passiva			53.069	43.566



LPKF

Konzernkapitalflussrechnung gemäß IAS 7

	Anhang	1999 TDM	1998 TDM
Laufende Geschäftstätigkeit			
Jahresüberschuss		4.620	3.017
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		3.016	2.077
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		-3	-285
Veränderungen der Vorräte, Forderungen und sonstiger Aktiva		-2.669	-3.875
Veränderungen des sonstigen Fremdkapitals		2.378	-735
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(26)	7.341	199
Investitionstätigkeit			
Anlageinvestitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		-8.950	-3.377
Investitionen in Tochterunternehmen	(27)	1.545	
Anzahlungen auf Beteiligungen			-409
Erlöse aus Anlageabgängen		40	273
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-7.365	-3.513
Finanzierungstätigkeit			
Zahlung Dividende			-2.900
Einzahlung von Gesellschaftern			22.600
Eigenkapitalanteil Wandelschuldverschreibung		21	
Anteil anderer Gesellschafter			-108
Veränderung langfristige Bankdarlehen		-4.701	-626
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit		-4.680	18.966
Veränderung des Finanzmittelbestandes			
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbedarfes		37	28
Veränderung des Finanzmittelbedarfes		-4.703	15.652
Finanzmittelbestand am 1.1.99		16.788	1.109
Finanzmittelbestand am 31.12.99		12.122	16.788
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes			
Liquide Mittel (Kasse)		12.875	17.158
Kontokorrentverbindlichkeiten		-753	-369
Finanzmittelbestand		12.122	16.788

Konzernanhang 1999

Grundsätze der Aufstellung des Konzernabschlusses

Der Konzernabschluss auf den 31. Dezember 1999 der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, wurde nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt. Dabei fanden die am Bilanzstichtag geltenden Standards des International Accounting Standards Committee (IASC) Anwendung.

Die erstmalige Aufstellung des Konzernabschlusses nach den Vorschriften der IAS erfolgte zum Bilanzstichtag 31. Dezember 1996, wobei die für diesen Zeitpunkt maßgeblichen IAS-Auswirkungen aus Vorjahren in den Saldoverträgen zum 1. Januar 1996 berücksichtigt wurden.

Dem Konzernabschluss für 1997 lag der nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellte Konzernabschluss zugrunde. Notwendige Anpassungen an IAS wurden vorgenommen. Seit dem Geschäftsjahr 1998 wird ausschließlich ein Konzernabschluss nach IAS aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Konzernabschluss ist in Deutscher Mark aufgestellt worden.

Konsolidierungskreis

Neben der Konzernmutter LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, sind folgende Tochterunternehmen in den Konzernabschluss einbezogen worden:

Konzernanhang

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Erwerb
Vollkonsolidierung			
ELASER Gesellschaft für Elektronik, Laser und Automation GmbH	Suhl/Thüringen	100,0	1989
LPKF d.o.o.	Kranj/Slowenien	75,0	1995
Franklin Industries N.V.	Mechelen/Belgien	100,0	1999
LPKF Laser & Electronics Inc.	Wilsonville/USA	60,0	1999
A-Laser Inc.	Beaverton/USA	100,0	1999
LPKF Motion & Control GmbH	Suhl/Thüringen	50,9	1991
LPKF Properties LLC	Wilsonville/USA	60,0	1999
LPKF France S.A.R.L.	Frankreich	94,0	1999
LPKF Laser Components GmbH	Garbsen	80,0	1999
Equity-Konsolidierung (GuV)			
LPKF Motion & Control GmbH (bis Ende 1999)	Suhl/Thüringen	50,9	1991

Der Konsolidierungskreis hat sich im Jahr 1999 wie folgt geändert. Die Firmen LPKF Laser & Electronics Inc. und A-Laser Inc. wurden durch zusätzlichen Anteilerwerb seit Jahresbeginn und LPKF Motion & Control GmbH zum 31.12.1999 für das Jahr 1999 vollkonsolidiert. Zusätzlich wurde sich in diesem Geschäftsjahr an den Gründungen der LPKF Properties LLC, LPKF France S.A.R.L. und LPKF Laser Components mehrheitlich beteiligt.

Konsolidierungsgrundsätze

Grundlage für den Konzernabschluss sind die nach einheitlichen Regeln zum 31. Dezember 1999 aufgestellten Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften. Bei der Kapitalkonsolidierung werden die Anschaffungswerte der Beteiligungen mit dem auf sie entfallenden Eigenkapitalanteil zum Zeitpunkt des Erwerbs verrechnet. Ein sich ergebender Unterschiedsbetrag wird den Vermögensgegenständen und Schulden insoweit zugerechnet, als deren Zeitwert vom Buchwert abweicht. Ein verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen und über 5 Jahre abgeschrieben. Zwischenergebnisse, Aufwendungen und Erträge sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den vollkonsolidierten Gesellschaften wurden eliminiert. Es werden nach der „liability method“ auf alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Werten und den Buchwerten der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten latente Steuern erfasst. Die Ertragssteuern sind aufgrund der gültigen Gesetze und Verordnungen berechnet.

Finanzierungsinstrumente

Die bilanzierten Finanzierungsinstrumente enthalten liquide Mittel, Beteiligungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige Fremdfinanzierungen und Finanzanlagen. Die einzelnen Bilanzierungsmethoden werden unter dem jeweiligen Posten erläutert.

Währungsumrechnung

Die Umrechnung der Jahresabschlüsse der ausländischen Gesellschaften erfolgt nach der Methode der funktionalen Währung. Bei dieser Umrechnung in Deutsche Mark wurden die Vermögensgegenstände und Schulden mit dem Mittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Die Aufwendungen und Erträge wurden mit dem Jahresdurchschnittskurs umgerechnet. Die Umrechnungsdifferenzen wurden ergebnisneutral unter dem Eigenkapital als Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausgewiesen.

In DM	Stichtagkurs		Durchschnittskurs	
	31.12.1999	31.12.1998	31.12.1999	31.12.1998
100 Französische Franc	29,81640	29,8180	29,81640	29,8290
100 Belgische Franc	4,84838	4,8483	4,84838	4,8476
10.000 Slowenische Tolar	98,5702	103,9900	100,6223	94,4269
1 US \$	1,94881	1,6730	1,8357	1,7592



LPKF

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Erfassung von Umsatzerlösen erfolgt grundsätzlich dann, wenn die Leistung erbracht bzw. die Waren und Erzeugnisse geliefert worden sind. Die Aufgliederung der Umsatzerlöse sowohl nach Geschäftsbereichen als auch nach regionalen Märkten ist in der folgenden Segmentberichterstattung wiedergegeben.

Segmentberichterstattung

Entsprechend den Regeln von IAS 14 (Segment Reporting) sind einzelne Jahresabschlussdaten nach Geschäftsbereichen und Regionen segmentiert, wobei sich die Aufgliederung an der internen Berichterstattung orientiert. Durch die Segmentierung sollen Ertragskraft und Erfolgsaussichten der einzelnen Aktivitäten des Konzerns transparent gemacht werden.

Die Geschäftsbereiche umfassen die folgenden Aktivitäten

- Rapid Prototyping umfasst die Weiterentwicklung, Produktion und Vermarktung von Fräsbohrplottern für den Weltmarkt.
- Unter Lasersystemen werden alle Systeme wie StencilLaser, Microlineler und sonstige neue Lasertechnologien zusammengefasst.
- Der Geschäftsbereich Schablonen beinhaltet die Aktivitäten der Firmen ELASER und A-Laser, die Stencils für die Leiterbahnenbedruckung herstellen.
- Auf Sonstiges entfallen alle kleineren Aktivitäten wie z.B. die Vermarktung spezieller Softwarepakete in Belgien usw..

Zur Überleitung auf die Konzernzahlen werden die konzerninternen Posten in einer gesonderten Spalte eliminiert. Einzelne Tätigkeiten, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet werden können, werden in der Spalte „Nicht verteilt“ dargestellt. Innenumsätze zwischen den Segmenten liegen nicht vor.

Die Segmentdaten wurden auf folgende Weise ermittelt:

- Das Segmentergebnis wird unter Einbeziehung der Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte, aber ohne Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie der Steuern ermittelt.
- Die Investitionen und Abschreibungen beziehen sich auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- oder Firmenwerte.
- Das betriebliche Segmentvermögen und die Segmentverbindlichkeiten setzen sich aus den zurechenbaren betriebsnotwendigen Vermögenswerten bzw. dem Fremdkapital ohne verzinsliche Ansprüche und Verbindlichkeiten, Finanzmittel sowie ohne Steuern zusammen.

TDM		Lasersysteme	Rapid Prototyping	Schablonen	Sonstiges	Nicht verteilt	Eliminierung	Gesamt
Außenumsatz	1999	17.178	17.058	3.431	952			38.619
	1998	15.594	13.451	2.101	786			31.932
Segmentergebnis	1999	819	1.041	1.194	121	6.042	108	9.325
	1998	2.100	1.875	342	129	1.127	95	5.668
Betriebsvermögen	1999	14.228	14.480	1.774		22.587		53.069
	1998	7.934	9.711	1.198		24.723		43.566
Verbindlichkeiten	1999	1.915	5.661	3.745	367	10.589	-5.489	16.788
	1998	1.236	2.060	1.557	257	7.515	-911	11.714
Investitionen	1999	2.890	2.607	2.404		2.595		10.496
	1998	876	958	281		1.591		3.706
Abschreibungen	1999	990	494	539		993		3.016
	1998	609	400	426		642		2.077
sonstige nicht zahlungs-	1999					3		3
wirksame Aufwendungen	1998					285		285

TDM		Deutschland	übriges Europa	Nord-Amerika	Süd-Amerika	Asien	Sonstige	Gesamt
Außenumsatz	1999	8.484	8.119	11.386	284	10.065	-	38.619
	1998	8.394	8.307	7.590	225	7.334	82	31.932
Betriebsvermögen	1999	40.018	5.685	7.366				53.069
	1998	39.221	4.345					43.566
Investitionen	1999	5.692	718	4.086				10.496
	1998	2.748	958					3.706

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Im Geschäftsjahr wurden gem. IAS 9 im Zusammenhang mit sechs Projekten bei der Laserentwicklung (TDM 2.537) und einem Entwicklungsprojekt im Bereich Rapid Prototyping Entwicklungskosten (TDM 280) aktiviert, da die Bedingungen nach IAS 9 kumulativ erfüllt waren. Die Abschreibung erfolgt über fünf Jahre.

3. Sonstige betriebliche Erträge

	1999 TDM	1998 TDM
Zuschüsse für Forschung und Entwicklung	1.107	1.671
Einstellung in den Abgrenzungsposten für Zuwendungen	-298	0
Auflösung Abgrenzungsposten für Zuwendungen	24	0
Erträge aus Kursdifferenzen	578	84
Leasing- und Mieterträge	114	39
Inanspruchnahme Garantierückstellungen	190	0
Übrige	303	285
	2.018	2.079

Die Zuschüsse für Forschung und Entwicklung betreffen Zuwendungen der öffentlichen Hand und werden für im Geschäftsjahr angefallene Kosten (Aufwandszuschuss) gewährt. Da ein Teil der Zuschüsse auf im Geschäftsjahr aktivierte Entwicklungsaufwendungen entfällt (TDM 298), wurde für eine periodengerechte Erfolgsdarstellung ein passiver Abgrenzungsposten für Zuwendungen gebildet, der gemäß der Nutzungsdauer der entsprechenden aktivierten Entwicklungsleistung aufgelöst wird (TDM 24).

4. Materialaufwand

	1999 TDM	1998 TDM
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.379	9.396
Aufwendungen für bezogene Leistungen	940	689
	9.319	10.085



Konzernanhang

5. Personalaufwand und Mitarbeiter

	1999 TDM	1998 TDM
Löhne und Gehälter		
Gehälter	8.901	6.056
Löhne	715	367
Übrige	142	151
	<u>9.758</u>	<u>6.577</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.420	954
Berufsgenossenschaft	66	36
Aufwendungen für Altersversorgung	144	320
	<u>1.630</u>	<u>1.310</u>
	<u>11.388</u>	<u>7.884</u>

Die Mitarbeiterzahl setzt sich zum 31. Dezember wie folgt zusammen:

	1999	1998
Produktion	34	22
Vertrieb	29	18
Forschung und Entwicklung	22	22
Technik und Verwaltung	37	30
	<u>122</u>	<u>92</u>

Bei LPKF Laser & Electronics AG werden weiterhin zum 31.12.1999 6 Teilzeitkräfte und 5 Auszubildende beschäftigt.

6. Abschreibungen

Die für verschiedene Gruppen des Anlagevermögens vorgenommenen Abschreibungen können dem Anlagenspiegel entnommen werden (10).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	1999 TDM	1998 TDM
Aufwendungen aufgrund des Börsenganges	0	2.197
Investor Relations	380	0
Werbe- und Vertriebsaufwand	3.535	2.731
Forschung und Entwicklung	803	807
Fremdarbeiten	1.021	382
Porto, Telefon, Telefax	374	358
Rechts- und Beratungskosten	162	322
Miete, Leasing	622	344
Kursverluste	243	163
Geschenke, Bewirtungen, Reisen	821	642
Übrige	3.429	1.042
	11.390	8.988

8. Finanzergebnis

	1999 TDM	1998 TDM
Erträge aus assoziierten Unternehmen	201	255
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	524	176
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-631
	-275	-200

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	1999 TDM	1998 TDM
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	3.457	1.483
Gewerbeertragsteuer	591	582
latente Steuern	381	385
	4.429	2.450

Die Körperschaftsteuer des Mutterunternehmens für das Jahr 1999 wurde auf der Grundlage des Vorschlages des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes berechnet. Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurde in Anlehnung an die Empfehlung des Hauptfachausschusses (HFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) ein Körperschaftsteuersatz von 30 % bei der Bewertung der aktiven und passiven latenten Steuern angewandt.

Der tatsächliche Steueraufwand ist im Geschäftsjahr beeinflusst durch eine strittige Steuernachzahlungsforderung in Höhe von TDM 550 bei der slowenischen Tochtergesellschaft, die in den Steuerrückstellungen berücksichtigt wurde.

Überleitung vom erwarteten zum tatsächlichen Steueraufwand

	1999 TDM	1998 TDM
Konzernjahresüberschuss vor Ertragssteuern	9.049	5.468
Erwarteter Steueraufwand (38 %)	3.439	2.078
Steuererhöhung aufgrund von Thesauierung	329	466
Periodenfremder Steueraufwand	550	-
Abweichende Steuersätze von Tochtergesellschaften	112	-85
sonstige Abweichungen	-1	-9
Tatsächlicher Steueraufwand	4.429	2.450



Konzernbilanz

Aktiva

10. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens zeigt folgende Übersicht:

	Stand	Zugänge durch	Währungs-	Zugang	Umgliederung	Abgang	Stand
	1.1.1999	Konsolidierung	differenzen	Umbuchung		Umbuchung (U)	31.12.1999
	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM	TDM
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2	0	0	0	0	2	0
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Software	545	120	0	55	0	0	720
Geschäfts- oder Firmenwert	86	0	0	1.636	0	0	1.722
Entwicklungsleistungen	551	0	0	2.817	0	0	3.368
Nutzungsrechte	1.158	0	23	361	0	0	1.542
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.340	120	23	4.869	0	0	7.352
Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.846	142	1	1.801	556	0	6.346
technische Anlagen und Maschinen	5.671	3	0	1.008	-304	0	6.378
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.779	1.528	111	2.037	511	237	8.729
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	808	1.023	0	781	-763	45	1.804
	15.104	2.696	112	5.627	0	282	23.257
Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen	36	0	0	0	0	0	36
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1.026	0	0	170	0	1.196	0
Anzahlungen auf Beteiligungen	409	0	0	0	0	409	0
sonstige Ausleihungen	2	0	0	5	0	0	7
	1.473	0	0	175	0	1.605	43
	18.919	2.816	135	10.671	0	1.889	30.652

Die aus Unternehmenserwerben resultierenden Geschäfts- und Firmenwerte (aktive Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung) werden aktiviert und planmäßig erfolgswirksam über die jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte aus dem Erwerb von Unternehmen sind in der Position „Abschreibungen“ enthalten. Die Zugänge bei den Geschäfts- und Firmenwerten im Geschäftsjahr resultieren aus den unter Tz 27 dargestellten Unternehmenserwerben.

Software wird als immaterieller Vermögensgegenstand mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Der Geschäfts- oder Firmenwert ist im Rahmen der Konsolidierung entstanden und gemäß IAS 22 aktiviert worden.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen für sechs Laserentwicklungen und einer Entwicklung im Bereich Rapid Prototyping werden mit den angefallenen Personal- und Materialkosten bewertet. Die Nutzungsrechte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Die Herstellungskosten umfassen die Materialeinzel- und -gemeinkosten sowie Fertigungseinzel- und -gemeinkosten. Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungswert weniger als DM 800,- beträgt, werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Konzernanhang

Konzern-Anlagenspiegel
gem. IAS der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999

Stand 1.1.1999 TDM	Zugänge durch Konsolidierung TDM	Währungs differenzen TDM	Abschreibungen		Auflösung TDM	Stand 31.12.1998 TDM	Restbuchwerte	
			Zuführung TDM	Umgliederung TDM			31.12.1999 TDM	Vorjahr TDM
2	0	0	0	0	2	0	0	0
461	96	0	72	0	0	629	91	84
51	0	0	274	0	0	325	1.397	35
0	0	0	222	0	0	222	3.146	551
150	0	-1	278	0	0	427	1.115	1.007
0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	96	-1	846	0	0	1.603	5.749	1.677
743	0	1	171	0	0	915	5.431	3.103
2.712	3	0	1.170	-112	0	3.773	2.605	2.959
3.671	1.057	46	830	112	178	5.538	3.191	1.108
0	0	0	0	0	0	0	1.804	808
7.126	1.060	47	2.171	0	178	10.226	13.031	7.978
0	0	0	0	0	0	0	36	36
0	0	0	0	0	0	0	0	1.026
0	0	0	0	0	0	0	0	409
0	0	0	0	0	0	0	7	2
0	0	0	0	0	0	0	43	1.473
7.790	1.156	46	3.017	0	180	11.829	18.823	11.128

Es werden folgende Nutzungsdauern unterstellt:

	Jahre
Software	3
Geschäfts- oder Firmenwert	5
Entwicklungsleistungen	5
Nutzungsrechte	5
Gebäude	25
Außenanlagen	10
Technische Anlagen und Maschinen	3-10
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-10

Die unter den Finanzanlagen an verbundenen Unternehmen ausgewiesene Beteiligung an der Franklin Industries B.V., Niederlande, soll veräußert bzw. liquidiert werden und wurde daher gem. IAS 27.13 (a) nicht in die Konsolidierung einbezogen.



LPKF

Konzernanhang

11. Vorräte

Die Vorräte werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem jeweils niedrigeren realisierbaren Nettoverkaufswert bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Waren werden mit dem gleitenden Durchschnitt der Anschaffungskosten bewertet.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse enthalten Fertigungseinzel- und -gemeinkosten sowie Materialeinzel- und -gemeinkosten.

12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	1999 TDM	1998 TDM
Nominalbetrag der Forderungen	6.118	4.611
Einzelwertberichtigung	./ 11	./ 22
Pauschalwertberichtigung	./ 32	./ 41
Forderungsbestand nach Wertberichtigungen	6.075	4.548

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bilanziert worden. Konkrete und latente Ausfallrisiken wurden durch ausreichende Wertberichtigungen berücksichtigt.

13. Sonstige Vermögensgegenstände

	1999 TDM	1998 TDM
kurzfristige Darlehen	208	22
Umsatzsteuer	445	572
Gewerbesteuer	0	178
Rückdeckungsversicherung	150	120
Übrige	862	159
	1.665	1.524

TDM 150 haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

14. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus Kassenbestand TDM 18 (Vorjahr: TDM 14) sowie Guthaben bei Kreditinstituten TDM 12.857 (Vorjahr: TDM 17.096).

Liquide Mittel umfassen für den Zweck der Finanzierungsrechnung Kassenbestände und Bankguthaben, gemindert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. In der Bilanz erfolgt ein getrennter Ausweis von Vermögensgegenständen und Schulden.

15. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausbezahlte Miete und Versicherungsbeiträge in Höhe von TDM 49 (Vorjahr: TDM 84).

16. Steuerabgrenzungsbetrag

Als aktiver Steuerabgrenzungsbetrag wurden latente Steuern im Wesentlichen aufgrund von Verlustvorträgen, Zwischengewinnen und der Einstellung des Sonderpostens für Zuwendungen gebildet. Aktive wie passive latente Steuern wurden mit dem Steuersatz für Ausschüttungsbelastung berechnet. Die passiven latenten Steuern sind ausschließlich auf aktivierte Entwicklungsleistungen gebildet worden. Die Entwicklung der latenten Steuern stellt sich wie folgt dar:

Aktive latente Steuern

	1999 TDM	1998 TDM
Steuerliche Verlustvorträge	116	–
Sonderposten	82	–
Zwischengewinneliminierung und andere abzugsfähige temporäre Unterschiede	177	85
	375	85

Passive latente Steuern

	1999 TDM	1998 TDM
Aktivierte Eigenleistungen	944	165

Passiva

17. Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital wurde zunächst gemäß Gesellschafterbeschluss vom 11. März 1998 durch Umwandlung von Rücklagen in Höhe von TDM 650 um TDM 4.350 auf TDM 5.000 erhöht. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 2. Juni 1998.

Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Oktober 1998 wurde sodann das Grundkapital gegen Bareinlagen von TDM 5.000 um TDM 5.500 auf TDM 10.500 durch Ausgabe von 1.100.000 auf insgesamt 2.100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöht. Die neuen Aktien wurden zum rechnerischen Nennwert von DM 5,- je Aktie ausgegeben.

18. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage resultiert aus dem gezahlten Aufgeld bei der Ausgabe von Aktien der Muttergesellschaft aus dem Vorjahr zuzüglich des Optionspreises der Wandelschuldverschreibung aus dem laufenden Geschäftsjahr.

19. Genehmigtes Kapital/bedingtes Kapital

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Oktober 1998 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals das Grundkapital um bis zu TDM 2.500 zu erhöhen. Diese Ermächtigung ist bis zum 30. Oktober 2003 befristet. Ferner wurde eine bedingte Kapitalerhöhung in Höhe von TDM 500 im Rahmen einer Mitarbeiterbeteiligung durch Wandelschuldverschreibungen beschlossen. Die Ausgabe von 100.000 Wandelschuldverschreibungen ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, in vollem Umfang vom Vorstand und Mitarbeitern der Gesellschaft sowie mit ihr verbundenen Unternehmen angenommen worden. Je DM 5,- Nennbetrag Schuldverschreibungen berechtigen den Inhaber bei Ausübung des Wandlungsrechtes zum Erwerb einer neuen Stückaktie der LPKF Laser & Electronics AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der LPKF Laser & Electronics AG von DM 5,-. Der Wandlungspreis zum Erwerb einer solchen Stückaktie wird nach einer Formel berechnet, die auf einem Vergleich der Wertentwicklung der LPKF Aktie zum Deutschen Aktienindex (DAX) basiert. Im Falle der Ausübung des Wandlungsrechtes ist für den Erwerb einer Stückaktie eine Barzahlung in Höhe des Betrages zu leisten, um den der Wandlungspreis den anteiligen Nennbetrag der umzutauschenden Schuldverschreibung übersteigt.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre (Laufzeitende 29. Dezember 2003) mit einer jährlichen Verzinsung von 5 %. Wandlung ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2001 möglich. Die Fremdkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibung wurde unter Berücksichtigung eines marktgerechten Zinses zum Barwert angesetzt und ist in der Periode um den Zinsanteil erhöht worden.

Vorstand und Aufsichtsrat des Mutterunternehmens schlagen vor, eine Dividende in Höhe von DM 0,50 pro Aktie auszusütten und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

20. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter

Der Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter an Tochtergesellschaften entwickelte sich wie folgt:

	1999 TDM	1998 TDM
Stand 1. Januar	902	864
Zugänge	1.261	38
Stand 31. Dezember	2.163	902



Konzernanhang

Die Veränderungen resultieren aus dem auf fremde Gesellschafter entfallenden Anteil am Jahresergebnis des Konzerns, Veränderungen aufgrund der Währungsumrechnung und aus Maßnahmen der Erstkonsolidierung.

21. Rückstellungen für Pensionen

In Deutschland besteht eine beitragsorientierte gesetzliche Grundversorgung der Arbeitnehmer, die Rentenzahlungen in Abhängigkeit vom Einkommen und den geleisteten Beiträgen übernimmt. Demgegenüber bestehen im Ausland leistungsorientierte Versorgungszusagen, die von den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des jeweiligen Landes abhängig sind und in der Regel auf Beschäftigungsdauer und -entgelt der Mitarbeiter basieren.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen beinhalten im Wesentlichen leistungsorientierte Pensionszusagen an die Vorstände der Muttergesellschaft (TDM 345). Außerdem werden leistungsorientierte Versorgungszusagen bei ausländischen Tochtergesellschaften ausgewiesen.

Die Berechnung erfolgte nach dem international üblichen Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Methode).

Die Berechnung der Pensionsverpflichtung bei der deutschen Muttergesellschaft erfolgte auf Grundlage der „Richtlinien“ von Dr. Klaus Heubeck, wobei künftige Rentenanpassungen mit 2 % berücksichtigt wurden. Der Abzinsungsfaktor beträgt 7 %.

22. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Rückstellungen werden für rechtliche oder effektive Verpflichtungen gebildet, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung der Verpflichtung zu einem Abfluss von Konzernressourcen führt und eine zuverlässige Schätzung der Verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann.

	1999 TDM	1998 TDM
Körperschaftsteuer	1.337	74
Gewerbesteuer	252	0
Solidaritätszuschlag	0	5
	1.793	79

Passive latente Steuern werden gesondert ausgewiesen und unter Tz 16 erläutert.

	1999 TDM	1998 TDM
Tantieme	549	545
Garantien	358	280
Urlaub	244	157
Übrige	179	171
	1.330	1.153

Rückstellungen In TDM	Stand 01.01.1999	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.1999
Rückstellungen für Pensionen	324	-	-	115	439
Steuerrückstellungen	79	35	-	1.545	1.589
Tantieme	545	545	-	549	549
Urlaub	157	157	-	244	244
Garantie	280	280	-	358	358
Übrige	171	171	-	179	179
Total	1.556	1.188	-	2.990	3.358

23. Verbindlichkeiten

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem nachfolgend dargestellten Verbindlichkeitspiegel:

Verbindlichkeitspiegel (in TDM) mit einer Restlaufzeit von

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.310 (6.448)	287 (1.318)	780 (2.627)	2.243 (2.503)	3.057 (5.891)	* (*)
Wandelschuldverschreibung	462 (446)	- (446)	462 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.094 (1.536)	2.094 (1.536)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
sonstige Verbindlichkeiten	3.787 (544)	3.774 (544)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	9.653 (9.159)	3.529 (4.029)	1.242 (2.627)	2.243 (2.503)	3.057 (5.891)	- (-)

* Grundschuld, Briefgrundschuld, Sicherungsübereignung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen.

Weitere Angaben zu den Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Darlehen in Höhe von TDM 3.616, deren Verzinsung sich auf 3,75 % p.a. bis 6,25 % p.a. beläuft.

Original Darlehen in TDM	Zinssatz p.a.	Laufzeit
53	5,25 %	07/97 – 05/00
101	6,25 %	02/98 – 12/01
1.286	3,75 %	09/99 – 09/09
2.250	5,85 %	10/99 – 10/09

24. Anleihe

Bei der Anleihe handelt es sich um eine Wandelschuldverschreibung, die unter der Tz 19 erläutert wird.

25. Steuerabgrenzungsbetrag

Als passiver Steuerabgrenzungsbetrag wurden latente Steuern aufgrund der Aktivierung von Entwicklungsleistungen ausgewiesen. Die latenten Steuern wurden mit dem Steuersatz für Ausschüttungsbelastung berechnet.

Sonstige Angaben

26. Kapitalflussrechnung

In dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit sind Steuerzahlungen in Höhe von TDM 2.961 (Vorjahr: TDM 2.910) sowie Zinsausgaben von TDM 999 (Vorjahr: TDM 593) und Zinseinnahmen in Höhe von TDM 523 (Vorjahr: TDM 175) enthalten.

27. Unternehmenserwerbe

Zum 1. Januar 1999 hat LPKF Laser & Electronics AG 20 % der LPKF Laser & Electronics Inc., einer Vertriebsgesellschaft in Oregon/USA, übernommen und hält nun 60 % der Anteile.

Zum 1. Januar 1999 hat ELASER GmbH, eine 100 % Tochter der LPKF Laser & Electronics AG, 80 % der Anteile der A-Laser Inc., einem Dienstleister im Stencil Service in Oregon/USA, übernommen, so dass LPKF Laser & Electronics AG 20 % und ELASER GmbH nunmehr 80 % der Anteile der Gesellschaft halten.

Mit Wirkung zum 31.12.1999 hat LPKF Laser & Electronics AG weitere 0,9 % an der LPKF Motion & Control GmbH in Suhl/Thüringen erworben und hält nun 50,9 % der Geschäftsanteile.

Zum 1. Oktober 1999 wurde die LPKF France SARL als Vertriebsfirma für den Französischen Markt gegründet. LPKF Laser & Electronics AG hält 94,0 % an dieser Gesellschaft.

Zur gleichen Zeit fand die Neugründung der LPKF Laser Components GmbH, einem Handelsunternehmen für Laser Komponenten, mit Sitz in Garbsen statt. An diesem Unternehmen ist LPKF Laser & Electronics AG mit 80 % beteiligt.

Gleichzeitig wurde in Oregon/USA die LPKF Properties LLC gegründet, die das neue Firmengebäude an LPKF Laser & Electronics Inc. vermietet hat. LPKF Laser & Electronics AG ist hier mit 60 % beteiligt.

TDM	A-Laser	LPKF Inc.	LPKF M & C	LPKF Franklin	Total
Kaufpreis	2.345	409	36	159	2.949
Beizulegender Wert des anteilig erworbenen Nettovermögens	1.014	237	8	54	1.313
Goodwill	1.331	172	28	105	1.636

Ermittlung der Netto-Akquisitionen

TDM	A-Laser Konzernanteil	LPKF Inc. Konzernanteil	LPKF M & C Konzernanteil	LPKF Franklin Konzernanteil	Total
Anlagevermögen	272	236	1.152		1.660
Vorräte	239	421	1.401		2.061
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	436	676	343		1.455
Flüssige Mittel	607	581	552		1.740
Rechnungsabgrenzungsposten			24		24
Rückstellungen	-122	-102	-204		-428
Finanzschulden			-1.179		-1.179
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		-627	-1.065		-1.692
sonstige Verbindlichkeiten	-259		-186		-445
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten					
Equity-Beteiligungsansatz	-158	-474	-419		-1.051
Anteile Dritte		-474	-411	54	-831
Beizulegender Wert der Netto-Akquisition abzüglich Goodwill	1.014	237	8	54	1.313
Goodwill	1.331	172	28	105	1.636
Summe der Netto-Aktiva abzüglich Flüssige Mittel	2.346	409	36	159	2.950
Ausstehende Kaufpreisar	607	581	552		1.740
Anzahlung auf Kaufpreis	2.346				2.346
		-409			-409
Mittelabfluss der Unternehmenserwerbe	-607	-581	-516	159	-1.545



Aufsichtsratsmitglieder sind:

Klaus Sülter	Generalbevollmächtigter Cura Consult GmbH (Vorsitzender) IPO Partner-Consult AG, Wiesbaden (Vorsitzender des Aufsichtsrates)
Dr. Heino Büsching	Rechtsanwalt / Steuerberater (stellvertretender Vorsitzender) IPO Partner-Consult AG, Wiesbaden (stellvertretender Vorsitzender)
Udo B. Hartmann	Geschäftsführer der BB-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH Beirat der Breitfeld & Schlieckert GmbH, Karben

Die Vergütung des Aufsichtsrates belief sich auf insgesamt TDM 127, davon betrafen TDM 28 nachträglich das Geschäftsjahr 1998.

32. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach Schluss des Geschäftsjahres wurde ein Vertrag über ein MicrolineLaser-System abgeschlossen, was als Durchbruch in der Markteinführung dieser neuen Technologie angesehen werden kann.

Hannover, den 1. März 2000
LPKF Laser & Electronics AG



Bernd Hildebrandt



Bernd Hackmann



Dr. Jörg Kickelhain

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Konzernabschluss der LPKF Laser & Electronics AG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses nach den International Accounting Standards des IASC (IAS) liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob der Konzernabschluss den IAS entspricht. Einige der dem Konzernabschluss zugrunde liegenden Einzelabschlüsse wurden durch andere Abschlussprüfer geprüft. Soweit sich unser Bestätigungsvermerk auf Werte bezieht, die diese Einzelabschlüsse betreffen, beruht er ausschließlich auf dem Bestätigungsvermerk dieser Abschlussprüfer. Die entsprechenden Werte betreffen ca. 28 % der Konzernbilanzsumme und 35 % der Konzernumsätze.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf der Grundlage unserer Prüfung sowie der Bestätigungsvermerke der anderen Abschlussprüfer vermittelt nach unserer Überzeugung der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den IAS ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres.

Unsere Prüfung, die sich nach den deutschen Prüfungsvorschriften auch auf den vom Vorstand aufgestellten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Konzernlagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes nach deutschem Recht erfüllen.

Hannover, den 17. März 2000

SOCIÉTÄTS TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. W. Gebler
Wirtschaftsprüfer

Dr. M. Schellhorn
Wirtschaftsprüfer



Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics AG

Jahresabschluss auf den 31. Dezember 1999 der
LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen

Bilanz

Aktivseite

	TDM	31.12.1999 TDM	Vorjahr TDM
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	43		84
Nutzungsrechte	140		175
	183		
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.744		3.103
technische Anlagen und Maschinen	1.411		1.633
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700		783
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	781		808
	7.636		
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.303		402
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	769		0
Beteiligungen	0		167
sonstige Ausleihungen	0		409
	2.072	9.891	
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40		18
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0		172
fertige Erzeugnisse und Waren	8.947		6.341
geleistete Anzahlungen	670		833
	9.657		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.711		4.044
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.805		304
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		514
sonstige Vermögensgegenstände	1.042		1.380
	7.558		
Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.424	27.639	16.459
Rechnungsabgrenzungsposten		25	87
		37.555	37.716

Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics AG

Jahresabschluss auf den 31. Dezember 1999 der
LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen

Bilanz

Passivseite

	TDM	31.12.1999 TDM	Vorjahr TDM
Eigenkapital			
gezeichnetes Kapital	10.500		10.500
Kapitalrücklage	17.121		17.100
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	1.534		50
Jahresüberschuss	2.719		1.484
		31.874	
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	345		331
Sonderrückstellungen	399		79
sonstige Rückstellungen	983		1.101
		1.728	
Verbindlichkeiten			
Anleihe, davon konvertibel DM 500.000,00	500		0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.937		4.767
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			446
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	631		743
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	423		606
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		185
sonstige Verbindlichkeiten	462		324
davon aus Steuern (TDM 162)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (TDM 171)			
		3.953	
		37.555	37.716



LPKF

Jahresabschluss der
LPKF Laser & Electronics AG

Gewinn- und Verlustrechnung

	TDM	31.12.1999 TDM	Vorjahr TDM
Umsatzerlöse		32.140	28.265
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		756	-546
andere aktivierte Eigenleistungen		134	25
sonstige betriebliche Erträge		2.036	1.934
Gesamtleistung		35.066	29.678
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.656		11.425
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.978		5.457
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: DM 120.667,85 (TDM 378)	1.116		1.197
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.380		1.192
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	3		55
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.590	30.723	4.853
		4.343	5.499
Erträge aus Beteiligungen	175		122
davon aus verbundenen Unternehmen: DM 174.857,14 (TDM 54)	0		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen an Organgesellschaft weiterbelastete Gewerbesteuerumlage	444		340
	108		90
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	451		
davon aus verbundenen Unternehmen: DM 41.196,32 (TDM 43)			78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: DM 0,00 (TDM 0)	352	826	450
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.169	5.679
Außerordentliche Erträge		0	0
Außerordentliche Aufwendungen		0	2.197
Außerordentliches Ergebnis		5.169	3.482
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.437		1.985
sonstige Steuern	13	2.449	13
Jahresüberschuss		2.719	1.484
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.534	50
Bilanzgewinn		4.253	1.534



Impressum

Herausgeber

LPKF Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
Germany

Konzept, Koordination und Redaktion

Peter Kirch Communications, Hannover
Telefon: +49 (0) 5 11-8 56 54-0
Internet: www.kirch.de

Gestaltung

Ahlers Heinel Werbeagentur, Hannover
www.ahlersheinel.de

Auflage

4000 Deutsch
1000 Englisch

März 2000



LPKF Laser & Electronics AG

LPKF Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen

Telefon +49 (0) 51 31-70 95-0
Fax +49 (0) 51 31-70 95-90
Internet www.lpkf.de
E-Mail lpkf@lpkf.de

